

RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гнезда передатчика RJ45 (магнитные) для гигабитных систем (1000 Base-T) со встроенной компенсацией активно противодействуют индуктивным и емкостным соединениям и экономят место на печатной плате.

Ассортимент продукции включает следующие модели:

- 90°, лежащая (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
- Защелка верх / защелка вниз;
- Технология пайки THT или THR
- Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и печатными площадками для экранирования
- Скорость передачи данных до 1 Гбит/с
- Упаковка – лоток (TY) или рулон (лента на катушке, RL)
- Совместимость с модульным разъемом RJ45 в соответствии со стандартами ANSI/TIA-1096-A и IEC 60603
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В пер. тока, среднеквадратичное значение (2250 В пер. тока, амплитудное значение) в соответствии со стандартом IEEE 802.3
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В перем. тока (амплитудное значение) или ≥ 1500 В пост. тока в соответствии со стандартом с IEC 60603

- Соответствие требованиям IEEE 802.3 (1000BASE-T, 1 Гбит/с, IEEE 802.3ab или 100BASE-TX, 100 Мб/с, IEEE 802.3u)

Особенности и преимущества:

- Расширенный диапазон температур: от -40 до $+85$ °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик
- Слой золота повышенной прочности (30 мкм) для улучшения защиты от коррозии
- Расстояние по меньшей мере 0,3 мм обеспечивает отличный результат пайки

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с, Соединение THT/THR под пайку, 90°, Фиксатор — опция: снизу, Выводы для экранирования: нет, 30...80 μ m Ni / ≥ 30 μ m Au, LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Таре
Номер для заказа	2485370000
Тип	RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL
GTIN (EAN)	4050118495966
Кол.	200 Шт.
Упаковка	Таре

RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	21,5 мм	Глубина (дюймов)	0,846 inch
Высота	16,9 мм	Высота (в дюймах)	0,665 inch
Высота, мин.	13,6 мм	Ширина	31,2 мм
Ширина (в дюймах)	1,228 inch	Масса нетто	8,81 g

Упаковка

Упаковка	Tape	Длина VPE	356 мм
VPE с	354 мм	Высота VPE	128 мм
Диаметр катушки с лентой \varnothing (A)	330 мм	Поверхностное сопротивление	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$

Системные характеристики

LED	Да	Вид защиты	IP20
Вид соединения	Соединение под пайку	Выводы для экранирования	нет
Длина контактного штифта (l)	3,2 мм	Допуск на расположение выводов под пайку	$\pm 0,1$ мм
Категория эксплуатационных характеристик	1000 Мбит/с	Количество контактных штырьков на полюс	1
Количество полюсов	8	Материал экрана	Латунь
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Поверхность экрана	никелированный
Прямое напряжение, макс.	2,5 V	Прямое напряжение, мин.	1,8 V
Прямой ток	20 mA	Размеры выводов под пайку	восьмиугольный
Серия изделия	Данные OMNIMATE – штекер преобразователя RJ45	Скорость передачи	1000 Мбит/с
Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка ручную, Пайка волной припоя	Угол вывода	90°
Фиксатор — опция	снизу	Цвет левого светодиода	зеленый/желтый
Цвет правого светодиода	зеленый/желтый	Циклы коммутации	750
Шаг в дюймах (P)	0,05 "	Шаг в мм (P)	1,27 мм
Экранирование	Да		

Электрические свойства

Номинальное напряжение	125 V	Номинальный ток	1,5 A
Электрическая прочность, контакт / контакт	1000 В DC	Электрическая прочность, контакт / экран	1500 В пост. тока

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 9T	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	II
Сравнительный показатель пробы (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал контактов	Фосфористая бронза
Материал контакта	Сплав меди	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Структура слоев штепсельного контакта	$30...80 \mu\text{m Ni} / \geq 30 \mu\text{m Au}$	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	85 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура, макс.	85 °C		

RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E471884

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Certificate of Compliance
Технические данные	CAD data – STEP
Уведомление об изменении продукта	PCN PCN
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format

RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

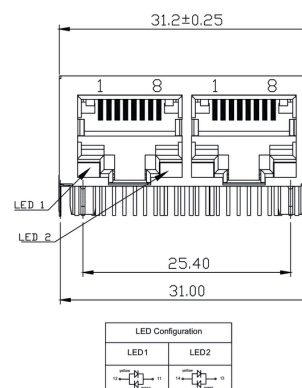
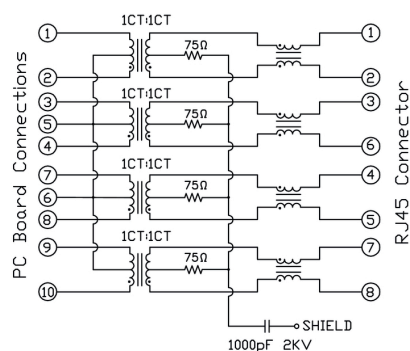
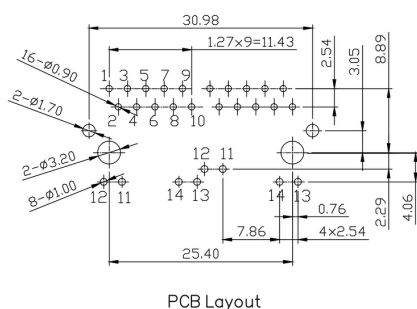


Схема соединений



Чертеж РСВ платы



RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схематическое представление

RJ45	G	I	R	1	U	3.2	E	4	G/Y/GY	T	JY RJ45G I R1 U 3.2E4GY/GY TY
									Packaging	TY RL	Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)
									LED	Y/G G/Y GY/GY O/O R/O ... N	Yellow/Green Green/Yellow (standard) Yellow/Green-Yellow Orange-Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED
									Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
									EMI tabs (ground fingers)	E N	E = with EMI tabs N = without EMI tabs
									Solder Pin length	3.2 1.6 D	3.2 mm 1.6 mm SMD
									Direction, latch style	U D V Y	Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up
									Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...	1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel
									Assembly on PCB	R S T	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave
									Performance Category	C5 C6 CSA C5e M G1 G10 U NP NP+	Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+

Типы кодов

Дата создания 2 июня 2024 г. 17:29:20 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.